

产品数据表

RE-123718 系列可贴装式底部填充胶膜

产品特点:

提高 CSP 和 BGA 焊点的可靠性。在加热过程中, 通过贴装加焊接相结合的方式降低成本(无需点胶工序)。
无资本支出, 设备和额外场地的需求。
生产员工最少化以降低劳动成本。
与现有无铅焊接材料的回流温度曲线一致, 无需额外调整。
空气或氮气保护回流兼容。
无需线路板预烘
100% 可返工
符合RoHS及无卤的环保要求
AOI设备易于识别

应用:

由于BGA原件的小型化, 可贴装式底部填充胶膜技术是被开发用来减少脆性无铅焊接材料在跌落或震动时焊点应力变化所产生的缺陷。
利用现有的编带及卷带送料系统与高速的贴装设备相结合在SMT装配线上实现简化生产。
底部填充胶膜不会与焊料或焊剂相互影响。
已生产了超过十亿台电子消费产品。
在美国和其他国家拥有专利。

介绍

无残渣及溶剂, 无需后续清洗。
自由流动, 不会干涉焊料或焊剂的功效。
微型精密切割技术允许其他SMT元件被放置在其附件的位置。

可靠性

底部填充胶膜为BGA/ CSP原件提供极好的粘接力及强度。
6英尺高度跌落测试结果显示, BGA焊点的可靠性提高超过10倍并获得40倍的改善。

产品生产

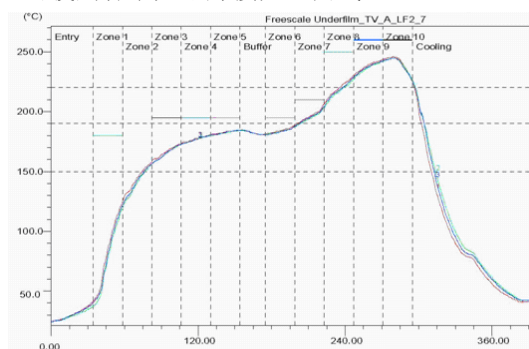
无需设备采购。
无需额外的地面空间要求。
由于无点胶工序因此不会产生废气。
无需对设备进行维护且不会产生针头堵塞。
无额外的固化周期。
无未固化残胶的清洁要求。
无需对板材预烘
100% 的材料利用率。
节省空间, 消除BGA/CGP原件的周边污染

包装

·提供符合EIA 481标准的卷带包装。
·使用精密载带, 盖带和标准料盘包装。
·使用标准防潮袋并真空密封。

工艺推荐

·丝网印刷焊锡膏, 贴装底部填充胶膜, 贴装BGA/ CSP, 回流焊接。
·无需脱水烘干 / 无需清洁工序。
·可使用标准无铅焊接回流曲线。



返工

底部填充胶膜可100%返工。

储存和运输

·无特殊存储或运输要求。
·超长保质期。

机械

邵氏硬度A	94A
拉伸模量	1200 PSI
维氏软化点	177 F
比重	1.22 g/cc
热膨胀系数	85 uin/in-F

安全性

底部填充胶膜在典型回流曲线下是一种良性的, 无毒的材料。

